EFC 易發精機
EASY FIELD CORPORATION

晶圓整平機

技術規格

外型尺寸	2420(L)mm X 2090(W)mm X 1700(H)mm
重量	2000KG
UPH	≧ 12 pcs
模料尺寸	490mm x Φ180mm、510mm x Φ180mm
最大張力值	30N
Wafer Size	≦300mm
滾輪壓力	≦40kgf

設備特性與優點

- 採用雷射量測測量晶圓翹曲度，精度達1um。
- 可以照測量得出的翹曲值，自動調整張力控制。
- 四軸向12位可各自控制，可對應不規則翹曲。
- 貼合才可承受250℃高溫，並可抗酸耐蝕。
- 最高可對應到7mm的翹曲Wafer。